

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2019-031

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	劲拓股份	股票代码	300400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋天玺	张娜	
办公地址	深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区	深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区	
传真	0755-89481574	0755-89481574	
电话	0755-89481726	0755-89481726	
电子信箱	zqzb@jt-ele.com	zqzb@jt-ele.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务和主要产品

公司主要从事专用装备的研发、生产、销售和服务，主要产品按大类可以划分为电子整机装联设备、光电模组生产专用设备以及航空专用制造设备等。公司业务层面推行事业部制，共5个事业部分别为智能制造事业部、视显事业部、封装项目部、FPD事业部和DAS事业部，其中智能制造事业部和DAS事业部负责公司电子整机装联业务，视显事业部、封装项目部和FPD事业部负责公司光电模组相关业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要业务及产品明细情况如下：

1、电子整机装联业务及主要产品

公司自成立以来，一直从事电子整机装联设备的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已经成为电子整机装联焊接设备行业的龙头企业。电子整机装联设备是公司主要的收入来源，该产品主要提供给下游电子制造企业，用来组建电子工业中的PCBA生产线。PCB是重要的电子部件，是电子产品中电子元器件之间电气与机械连接的载体，是现代电子工业的基础。本公司生产销售的电子整机装联设备具有广泛的应用空间，能够广泛应用于通讯、汽车、消费电子产品及国防、航空航天电子产品等生产过程。

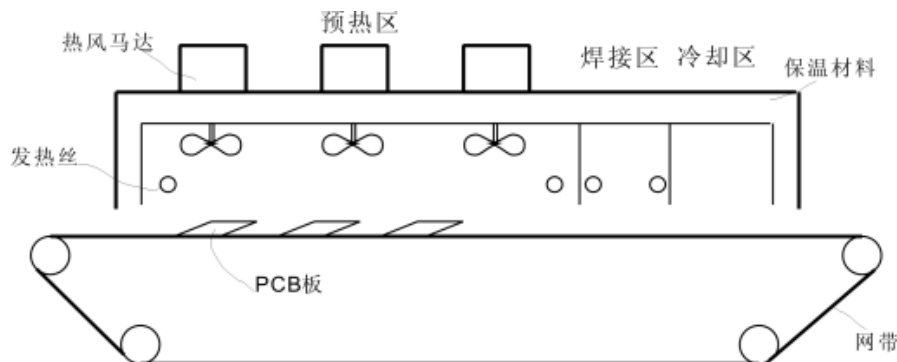
公司电子整机装联设备产品应用领域示例如下：

应用行业	涉及产品
消费电子制造业	电脑、笔记本电脑、数码摄像机、平板电视、DVD 播放机、机顶盒、DC/DV、移动存储、PND、MP3/MP4、电子书、CD、PS3、Xbox、UPS、LED 显示器等。
汽车电子制造业	汽车信息系统（行车电脑）、导航系统（GPS）、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。
通信设备制造业	手机、程控交换机、互联网设备等。
航空航天制造业	各类仪表仪器、无线通信、导航卫星。
国防电子制造业	各类侦测仪器、雷达、指挥控制系统。
其它电子制造业	打印机、复印机、投影仪等。

公司电子整机装联业务产品主要包含2类：电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备，具体情况如下：



(1) 电子焊接类设备

电子焊接类设备由公司自主研发、生产和销售，拥有温度控制及传热方面的核心技术，此类产品主要应用于电路板组装制程领域，客户为电子产品生产厂家，如伟创力、比亚迪及富士康附属企业等，主要工作原理如下图：



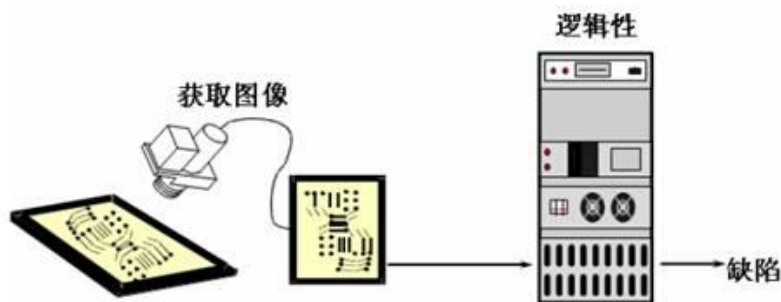
电子焊接类设备主要产品情况及应用领域如下表：

主要产品	主要功能及应用领域	代表产品外观示例
波峰焊	波峰焊能自动完成 PCB 板从涂覆助焊剂、预加热、焊锡及冷却等焊接的全部工艺过程，主要用于无铅焊接表面贴装元件、短脚直插式元件及混装型 PCB 板的整体焊接。	 <p>隧道式氮气波峰焊 NXS-450</p>
回流焊	主要应用于 SMT 表面贴装焊接，或者短脚元件的通孔焊接，通过加热对焊锡膏的熔融和冷却，实现元器件与 PCB 线路板之间形成可靠的电路连接。	 <p>无铅热风回流焊机 TEA 系列</p>

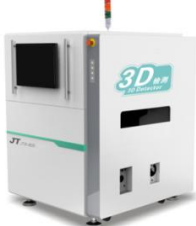

其他焊接设备	包括选择焊及 SMT 周边设备，主要应用于 SMT 或者 DIP 生产线中，通过这些小型设备将其他焊接或生产设备串联起来，实现各种设备之间的自动化生产，如上下料机、接驳台、转角机等。	 <p>LD/ULD 系列上/下料机</p>
高温垂直固化炉	主要应用于三防漆、填充胶等的固化。通过热风回流加热产品，在某个温度范围内保持一定的时间以完成胶水的凝固，此机种占地面积小，生产效率高，可实现在线式生产。	 <p>垂直固化炉 JTL-730</p>

(2) 智能机器视觉检测设备

智能机器视觉检测设备由公司自主研发、生产和销售，拥有运动控制和视觉识别方面的核心技术，此类产品主要应用于电路板组装制程领域，与回流焊等组成一条SMT生产线，客户为电子产品生产厂家，如伟创力、比亚迪及富士康附属企业等，主要工作原理如下图：



智能机器视觉检测设备主要产品情况及应用领域如下表：

主要产品	主要功能及应用领域	代表产品外观示例
AOI	主要用于电子产品生产中 PCB 上元件的装配品质检测及工艺品质控制。目前可实现离线式及在线式 2D、2.5D 及 3D 检测。	 <p>焊点及元器件检测 AOI-JTA-800</p>
3D-SPI	主要应用于电子产品生产过程中对锡膏印刷质量和工艺进行实时检测和调整，提高产品优质率。	 <p>自动 3D 锡膏检测 SPI-ZEN 系列</p>

2、光电模组业务及主要产品

近两年，公司以智能机器视觉为核心技术，结合专用装备制造为主线，利用公司优势资源，持续加大研发投入，将公司产品应用领域成功拓展到光电平板(TP/LCD/OLED)显示模组等精密生产专用设备领域，同时大力推进事业部改革，光电业

务方面组建了封装项目部、FPD事业部和视显事业部，各事业部设有独立的负责人进行专业化运作，各事业部相互协同发展。

(1) 封装项目部

封装项目部产品主要包括应用于双摄及三摄技术的摄像头模组封装设备、用于屏下指纹模组封装的光学指纹模组封装贴合设备、3D曲面贴合设备、超声波指纹等贴合机及点胶机等设备，主要代表产品外观示例如下：



光学指纹模组贴合设备

(2) FPD事业部

FPD事业部则着重于研发COG、FOG邦定设备、超声波指纹模组邦定设备及部分辅助类设备，如上料机和清洗机等，主要代表产品外观示例如下：



端子清洗机、COG绑定机、FOG绑定机

(3) 视显事业部

视显事业部主要负责研发生产公司3D玻璃和OLED的一部分设备，3D玻璃主要包括整个后端工艺如喷涂、曝光和显影，主要代表产品外观示例如下：



OLED DEMURA JTO-818

公司光电模组业务主要是研发和生产用于手机屏幕制造及3D玻璃制造等不同工艺阶段的光电模组专用设备，该类业务主要依托国内大型面板制造商和3D玻璃生产商。截至本报告披露日，公司光电模组专用设备根据产品主要功能不同划分为如下8大类，其中第8类D-Lami贴合设备为公司研发出的新产品。光电模组专用设备具体情况如下：

序号	主要产品		主要功能
1	生物识别模组生产设备	超声波指纹模组邦定设备	设备用于将指纹识别 Sensor 与 FPC（柔性线路板）之间的邦定连接。将已完成 IC 邦定的显示屏面板，进行 FPC（柔性线路板）邦定制程，含 ACF 贴附、FPC 高精度对位预压、FPC 本压、点胶四个主要工序。
		超声波指纹模组贴合设备	超声波指纹模组 IC+Sensor 贴合设备。
		光学指纹模组封装贴合设备	主要用于光学指纹模组的贴合、贴附、封边点胶及固化。
2	3D 贴合设备	3D 曲面贴合设备	设备是将 3D 盖板玻璃在真空状态下进行贴合，能应用于贴合装饰膜、防爆膜、Sensor 膜、光学膜等。
3	3D 玻璃设备	等离子清洗机	用于喷墨工序之前的玻璃盖板清洗及 IC、FPC 邦定工序之前的显示屏面板清洗。
		喷墨机	依照工艺将油墨均匀喷涂到玻璃盖板表面，喷墨的材料性能、喷墨厚度、均匀性决定了盖板的质量。
		预烤炉	将喷涂的玻璃进行油墨均匀加热固化，加热的均匀性、空气的洁净度都将对后续曝光品质产生影响。
		曝光机	通过 UV-LED 准直光源及掩膜片的共同作用，照射部分的油墨固定附着，未照射部分的油墨可显影清洗掉，玻璃盖板可呈现出图案、文字及视窗。
		固烤炉	喷涂曝光显影整线的最后一道工序，通过均匀加热，将呈现图案的油墨附着在玻璃盖板上。
4	显示屏模组封装设备	全自动 COG 邦定机	将已清洗的显示屏面板，进行 IC 邦定制程，含 ACF 贴附，IC 高精度对位预压，IC 本压三个主要工序。
		全自动 FOG 邦定机	将已完成 IC 邦定的显示屏面板，进行 FPC（柔性线路板）邦定制程，含 ACF 贴附，FPC 高精度对位预压，FPC 本压三个主要工序。
5	摄像头模组生产设备	摆料机\UV 固化机	双摄像头、三摄像头模组支架组装自动摆料、自动固化设备，和搭载机自动连线使用。
		搭载机	主要用于摄像头模组中音圈马达、镜头、支架、铁壳的搭载。
		COB 摄像头模组热压机	应用于手机摄像头线路板晶片点胶后和镜头模组组合后，修正上游设备组装后产生的上下平整度偏差，并进行加热固化。
		点胶机	用于摄像头模组中电子元器件的封装、加固、补强及保护等工序。
6	OLED 设备	AMOELD 外部补偿设备	AMOLED 外部补偿是将 AMOLED 面板点亮后通过光学 CCD 照相的方法将亮度信号抽取出来，通过 RGB（8bit）黑白灰采集图片计算需修补数据（DEMURA）并写入修复 Flash 中，完成缺陷修补并复检修复结果的设备。
7	光电模组检测设备	触控显示一体模组点亮检测 AOI	触屏显示一体模组点亮检测 AOI 设备，是检测手机屏在制程中存在的漏液、异显、残影、点、线、团缺陷、MURA、漏光等问题；通过千万级主相机，多个百万级环侧相机拍摄，将手机屏幕上显示的缺陷用相机抓取形成高清晰图像，通过计算图像上的异常，判断手机与之对应的缺陷问题点。
8	D-Lami 贴合设备	3D-Lami 贴合设备	用于柔性 oled 屏与曲面玻璃盖板的贴合。

3、其他业务及主要产品

公司除研发生产电子整机装联设备和光电模组生产专用设备外，还研发生产部分航空专用制造设备和其他设备。航空专用制造设备涉及航空航天数字化柔性装配系统，主要应用于飞机及其他航空器的制造；公司其他设备主要涉及一些主要业务的辅助类设备，主要产品及功能介绍如下表：

主要产品		主要功能
激光辅助设备	激光打标机	主要用于 PCB、FPC 板材上的二维码雕刻，实现产品制程、销售可追溯。
	激光分板机	主要应用于 PCB、FPC 材料的激光切割、精密切割。

（二）主要经营模式

1、销售模式

（1）在国内市场采取直销为主代理商销售为辅的销售模式

公司产品以内销为主，在国内市场上，公司采取订单直销为主，代理商销售为辅的销售模式。公司拥有自己的独立销售团队，可以直接与客户进行产品信息沟通，及时了解客户需求，把握市场动向。公司订单的获得方式主要为客户上门或主动营销。另外，公司还积极通过举办行业技术及工艺交流会、产品推介会以及参加国内外各种专业展会、招标会的方式获得订单。

对于公司销售网络未覆盖到的市场区域，公司实行代理商机制，各代理商均负责一定区域或以具体客户单位产品销售工作，公司负责建立与代理商之间的沟通与联系渠道，不定期地向代理商提供宣传资料、信息、政策以及推广方案与管理制度等方面的支持。

（2）在国际市场采取直销与经销商销售相结合的销售模式

目前公司产品出口销售占比较小，在国外市场，公司采取直销与经销商销售相结合的销售模式。

2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，即根据销售订单来制定公司的生产计划。在电子整机装联设备生产方面，公司拥有钣金、机加及装配等完整的全工序生产制造体系，能够采取自主标准化生产模式，公司下设PMC部全面负责协调管理生产系统的工作，由PMC部按销售部门下达的订单指令组织安排钣金车间、机加工车间、装配车间进行生产，并和品管部共同配合，负责原材料入库、产品生产、产品测试、质量控制和产品发运的全过程；在光电模组生产专用设备生产方面，产品属于专用设备，定制化特点突出，产品种类型号较多，在生产实践中公司总结了一套与此特点相适应的小量多批次的柔性化生产模式，能够根据客户需求进行定制化生产。

3、采购模式

在采购交货管理方面，公司采购部门按照PMC部门下发的请购单进行采购，严格遵循“同一质量水平比价格、同一价格水平比质量、同一质量价格水平比服务”的三比采购法原则，确保交期基本与生产计划衔接，同时公司严格根据销售、生产和原材料情况，确定采购需求，避免存货积压。在供应商选择方面，公司严格按照《供应商评审与管理程序》对供应商的品质、供货能力进行详细评审，通过评审的供应商才能成为合格供应商，公司会择优选择供应商，从而保证产品质量和客户满意度；在关键物料方面，公司主要采用知名品牌产品，与供应商建立长期合作关系，确保供货稳定及时；在常规物料方面，在保证产品品质及交期的前提下，公司会通过询、比、议价，选择品质稳定、价格更优的产品和供应商。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入59,089.73万元，同比增长23.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,097.83万元，同比增长13.25%。公司业绩实现增长的驱动因素如下：

1、行业因素

报告期内，公司电子整机装联行业洗牌加速，一些不满足环保要求的落后产能逐渐被淘汰出局，行业集中度得到提升，进而促进了电子整机装联行业龙头企业的公司传统业务市场份额进一步提升。公司经过多年经营，在行业内树立了较好的品牌形象，积累了丰富的行业经验和客户资源，具备较强的市场竞争能力和议价能力。

2、市场因素

报告期内，国内消费升级趋势拉升了终端客户对中高端3C消费电子产品的需求，带动下游市场相关产品日益向中高端化的方向发展，下游市场品牌集中度提升，对高质量的消费电子零部件的需求扩大，对模组设备的良率要求进一步提高，鉴于这种自上而下的传导效应，驱使下游市场一方面对智能检测类设备的需求增加，另一方面需要选择与公司这种品牌设备制造商合作，使用高品质的设备来提升自身产品良率。

3、自身优势

报告期内，公司依托多年积累的技术研发优势、全工序生产制造优势、品牌口碑优势、优质的服务能力及资金优势等，

不断研发推出高性能高精密度的电子焊接类设备，并结合客户需求进一步提升智能机器视觉检测设备的检测性能、检测效率及精准度，保障公司电子整机装联设备的销售收入持续稳定增长；同时公司光电模组专用设备得到市场认可，其中生物识别模组生产设备和摄像头模组生产设备实现销售收入，成为公司业绩增长点。报告期内，公司电子整机装联设备及光电模组专用设备的销售收入实现双增长，从而助推公司业绩增长。

（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位

1、行业格局和发展总体趋势

制造业是强国之基、富国之本，而装备制造业是制造业的核心组成部分，承担着为国民经济各部门提供工作母机、带动相关产业发展的重任，对制造业整体的稳定和发展具有不可替代的基础性作用。在我国产业迈向全球价值链中高端的过程中，装备制造业承担着重大的历史责任。国家制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施对装备制造产业进行大力扶持，促进高端装备制造产业的发展。2009年5月《装备制造业调整和振兴规划》出台，其实施细则中提到，要依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。随后，国家对智能制造装备产业的政策支持力度不断加大，2012年发布的《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、2015年出台的《中国制造2025》等政策，都表明国家把智能装备制造系统作为制造业发展和转型升级的重点领域。近年来，我国装备制造业一度发展迅猛，生产制造能力显著增强，然而我国自主品牌制造业的核心竞争力普遍不强，中低端产能过剩，很多产业的高端环节都被外资品牌牢牢掌控，很大程度上依赖着大规模的投资和出口，在关键零部件和核心技术方面却略显薄弱。与制造强国相比仍差距较大，装备制造业的发展受核心能力不足，发展方式粗放，特别是受国际金融危机及欧债危机的影响，我国装备制造业面临着前有堵截、后有追兵的严峻形势。装备制造业特别是其中的智能装备制造已成为国际竞争的制高点。

智能变革，装备先行，装备制造业的转型升级是实现“中国制造2025”目标的必由之路。我国智能制造装备行业已初步形成了以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的产业体系。随着物联网和传感器技术的广泛应用，数据的采集、存储、传输、展现、分析与优化都具备了良好的技术基础，装备制造技术的数字化、网络化和智能化升级，催生了智能制造、服务型制造等新的生产方式，也涌现了远程运维服务、个性化定制等大量新业态新模式，为新一轮产业变革提供主引擎，我们应以数字化转型为抓手，加快中国装备制造业的转型升级。实现我国装备制造业的高端化发展，不仅需要国家政策支持，企业自身也需要进行改革，要勇于探索实践符合中国国情的智能制造发展模式，努力提高自主创新能力，积极为用户挖掘和创造新的价值。

2、电子整机装联设备市场环境

电子装联专用设备包括焊接设备、AOI检测设备和贴片机等。电子装联是指电子元器件、光电子元器件、基板、导线、连接器等零部件，根据设定的电气工程模型实现装配和电气连通的制造过程。电子整机装联是电子产品生产过程中的关键环节，而电子装联专用设备的技术水平及运作性直接影响产品的电气连通性、稳定性及使用的安全性，电子装联技术也是电子产品实现小型化、轻量化、多功能化和高可靠性的关键技术，因而随着全球电子元器件的迅猛发展，电子元器件逐渐微型化和薄型化，封装方式也在不断变化，各种新技术新工艺不断涌现，促使电子装联设备朝着智能化、高精度、高速度方向发展。

电子整机装联设备主要应用于PCBA制程中的表面贴装工艺，并广泛应用于3C类消费电子产品印制电路板的贴装过程，下游应用领域涉及3C行业制造企业，如消费电子制造业、汽车电子制造业、通信设备制造业、航空航天制造业以及国防电子制造业等。因而公司电子整机业务与PCB行业及下游行业的发展状况密切相关，如下游行业增长则带动本行业的增长，反之，如果下游行业出现萎缩，也会制约本行业的发展。中国是全球最大的消费电子产品市场，形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带，且PCB下游应用领域众多，受单一因素的影响较小。未来很长一段时间内，PCB在电子产品中仍具有不可替代性，能够为电子整机装联行业的发展提供有力的支撑。根据公开资料显示，全球领域PCB主要在3C产品领域存在大规模应用，2013-2017年间，我国3C产品制造业经过高速发展，行业规模迅速扩大，2018年传统3C产品市场需求开始放缓，但是传统3C产品普及率较高，存量市场空间大，消费者更换需求仍将推动市场出货量保持较高水平，尤其是更换周期较短的智能手机领域。同时，3C类消费电子行业热点频现，如可穿戴智能设备、无人机、扫地机器人及柔性屏手机等市场需求开始扩大，进而催生新的技术应用和工艺变革，逐步打开新的市场空间，为电子整机装联设备的发展提供了

稳定的推动力。未来物联网、汽车电子、工业4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱PCB需求增长的新方向，汽车电子和医疗器械等下游市场的新增需求也有望爆发，能够为电子整机装联行业提供新的发展机遇。

3、光电模组专用设备市场环境

目前公司主要是研发、生产和销售针对屏幕及配件的光电模组专用设备，主要客户有国内知名模组厂和面板厂。近几年，随着智能手机的消费升级，OLED凭借优越的性能，在智能手机市场的渗透率快速提升，OLED技术应用于电子产品的部分绝大多数为AMOLED，是面板界的新热点，国内面板厂争相扩大产能布局OLED，在大规模新建AMOLED生产线，并且以6代LTPS TFT-AMOLED产线为主，市场需求逐步释放。AMOLED当前主要的应用领域为智能手机，2018年度，全球智能手机市场共计出货14.05亿台，同比2017年度下滑4.1%，手机市场已进入存量竞争时代。但是随着多摄像头、屏下指纹、5G和折叠屏概念的兴起，智能手机在经历着新一轮的创新浪潮，将会带动手机行业新一轮的技术革新，技术迭代为手机发展注入新的动力，有望带动手机市场回暖，同时在技术创新的驱动下，生产制造环节的专用设备的需求不断被激发，未来有着广阔的市场空间。

4、公司行业地位

(1) 公司在电子整机装联设备制造行业地位

公司自2004年成立以来，历时近15年一直致力于深耕电子整机装联设备的研发、生产、销售和服务。①市场竞争方面：目前国内从事电子产品焊接设备的制造企业多数为中小企业，且主要集中在该领域的低端市场。公司较早打破了国外品牌垄断，参与到电子焊接设备中高端市场竞争。随着主要竞争对手之一的美国BTU公司逐步退出国内电子焊接市场，美国Heller公司成为目前公司在国内电子焊接设备高端市场的主要竞争者。根据中国电子专用设备工业协会的统计，公司在国内电子焊接设备的市场份额稳居第一。经过多年发展，公司已然成为国内电子焊接设备行业龙头企业；②技术研发实力方面：公司为国家高新技术企业，在电子焊接设备和检测设备方面拥有多项核心技术专利，拥有国内发明专利26项，美国发明专利1项，德国发明专利1项，计算机软件著作权61项。拥有独立的研发团队，并建立了较为完善的研发体系。自主研发能力和核心技术实力领先于同行；③生产制造实力方面：公司拥有钣金、机加、喷涂、装配等覆盖设备生产各环节的完整生产工序链，拥有已使用的自有老厂房建筑面积达2万余平米，尚待启用的自有新厂房面积约7万平，具备规模化的生产能力，且生产的产品具有完全自主知识产权，能够生产出高精度、高品质的产品，并快速响应市场需求，从而保障销售；④品牌和客户资源方面：公司深耕SMT细分行业近十五年，凭借优良的产品性能，在业内树立了良好的品牌形象，“JT/劲拓”品牌在国内国际市场具有一定的知名度，从而累计吸引和服务了超过4,000家客户，其中不乏国内外众多知名电子制造企业，如富士康附属企业、伟创力、蓝思科技、格力电器、华为、美的集团等。突出的品牌形象和丰富的客户资源为公司市场份额提供了保障；⑤服务能力方面：公司建立了完整的售前、售中、售后服务体系，能够为客户提供定制化服务，并组建了一支专业的售后服务团队，能够保障为客户提供24小时便捷的技术支持服务。⑥资金运营方面：作为深交所创业板A股上市公司，具备资金优势，且近年来公司一直保持合理的低负债运营，资金状况平稳，在复杂多变的经济环境下，依旧保持稳健运营，近年来经营业绩持续增长。⑦此外，公司顺应市场对智能检测类设备需求增加的趋势，依托自身在研发技术、生产制造、品牌、服务等方面的优势，以及庞大的电子焊接方面的存量客户资源，自主研发智能机器视觉检测设备以及电子整机装联业务前后端辅助配套设备，成为公司新的利润增长点。

(2) 公司在光电模组专用设备制造行业地位

为开辟新的业绩增量空间，近两年公司及时把握全面屏手机普及带来的全面屏技术相关市场机遇，积极在光电模组专用设备制造领域进行战略布局，依托国内大型面板制造商和3D玻璃生产商，公司成功研制出生物识别模组生产设备和摄像头模组生产设备，得到光电行业主流模组厂商和面板厂商的采购和认可，为公司继续研发光电细分领域的模组专用设备奠定了坚实基础。公司3D玻璃设备和显示屏模组封装设备等也陆续实现了销售。但是国内光电市场竞争较为激烈，公司起步较晚，市场竞争优势尚不明显。为扩大公司在光电业务方面的市场份额，公司加大光电设备研发投入，与下游客户保持紧密合作，提升光电设备方面的核心技术实力，紧随市场储备前瞻性技术，丰富光电设备类型。截至本报告期末，公司在OLED相关3D贴合设备、AMOLED外部补偿设备和光电模组检测设备的研发和销售方面均有进展，其中OLED相关3D贴合设备更是打破

国外一直以来的技术垄断，成功研制出样机在客户端测试，以期为公司业绩增色添彩。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	590,897,303.32	477,762,957.35	23.68%	328,498,464.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,978,322.89	80,336,800.16	13.25%	52,108,165.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,474,251.81	77,624,275.47	8.82%	45,961,037.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,104,664.45	65,865,484.57	85.38%	26,341,914.53
基本每股收益（元/股）	0.38	0.33	15.15%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.33	15.15%	0.22
加权平均净资产收益率	16.59%	17.43%	-0.84%	12.84%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	938,951,223.21	724,428,823.98	29.61%	572,515,730.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	602,242,664.38	494,850,216.49	21.70%	429,513,416.33

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	132,946,593.02	191,935,625.61	139,678,514.44	126,336,570.25
归属于上市公司股东的净利润	20,028,580.59	31,801,837.42	20,867,275.34	18,280,629.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,603,823.34	28,853,923.41	19,760,370.09	17,256,134.97
经营活动产生的现金流量净额	15,688,859.68	29,870,090.96	968,613.88	75,577,099.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,627	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,963	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

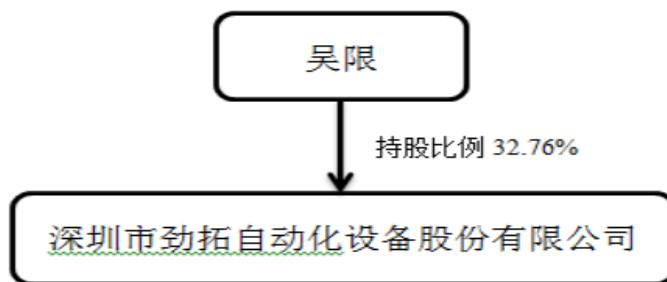
		例	股数量	增减变动情况	条件的股份数量	售条件的股份数量	股份状态	数量
吴限	境内自然人	32.76%	79,729,018	-1,999,982	73,556,100	6,172,918	质押	53,930,000
主遼	境内自然人	3.81%	9,278,700	-1,912,900	8,393,700	885,000	质押	3,900,000
深圳市前海小龙资产管理有限公司—小龙趋势 1 号私募证券投资基金	其他	3.48%	8,458,171	8,458,171	0	8,458,171	--	0
林秀芬	境内自然人	2.50%	6,074,422	5,024,422	0	6,074,422	--	0
深圳市君如资产管理顾问有限公司—创智 1 号私募基金	其他	2.48%	6,025,600	6,025,600	0	6,025,600	--	0
孔旭	境内自然人	2.11%	5,125,061	-2,797,339	0	5,125,061	质押	5,000,000
麦旺球	境内自然人	2.04%	4,972,349	416,736	0	4,972,349	--	0
深圳市君如资产管理顾问有限公司—赢丰成长 1 号私募基金	其他	1.94%	4,724,727	2,587,030	0	4,724,727	--	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	3,577,600	0	0	3,577,600	--	0
姚志刚	境内自然人	1.31%	3,184,978	3,184,978	0	3,184,978	--	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司—创智 1 号私募基金和深圳市君如资产管理顾问有限公司—赢丰成长 1 号私募基金系深圳市君如资产管理顾问有限公司旗下基金产品，由其统一管理。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

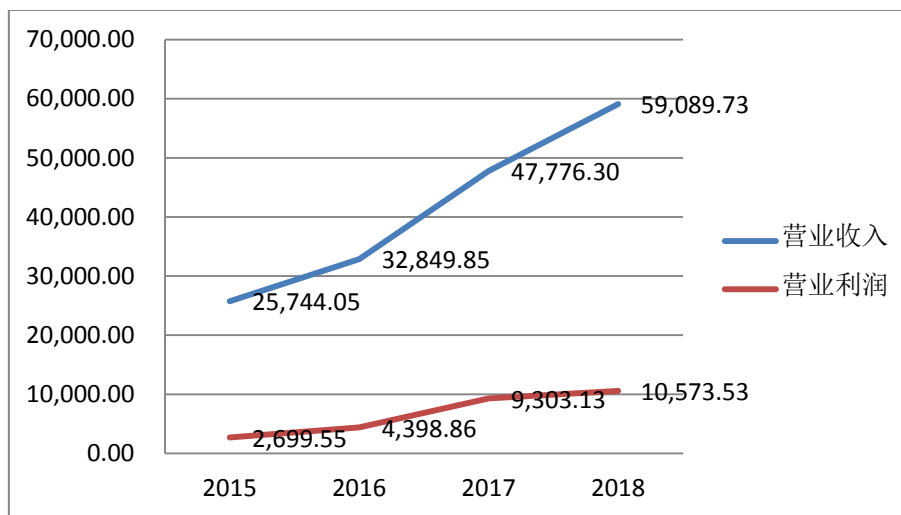
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是公司新老业务双轮驱动、协同发展初见成效的一年。公司秉承电子整机装联设备与光电模组生产专用设备双轮驱动发展战略，新老业务双轮驱动的产业布局初见成效，2018年度新老业务的销售收入和营业利润均实现双增长。电子整机装联业务方面：电子整机装联行业洗牌加速，进一步提升了公司市场占有率，助力公司稳坐电子整机装联行业龙头企业地位。公司凭借多年经营积累的行业经验和客户资源，依托自主研发的技术领先优势，不断研发推出高性能高精密度的电子焊接类设备，并结合客户需求进一步提升智能机器视觉检测设备的检测性能、检测效率及精准度，提升公司产品价值，增强公司的议价能力，保障公司电子整机装联设备的销售收入和净利润持续稳定增长。新业务方面：公司大力支持对光电模组生产专用设备新产品的研发投入，提升光电业务方面的核心技术，2018年度公司在光电模组生产专用设备方面取得突破性进展，其中生物识别模组生产设备和摄像头模组生产设备表现突出，得到行业认可，并被下游主流客户采购，进一步提升了公司整体业绩。

报告期内，公司电子焊接类设备及智能机器视觉检测类设备销售收入实现稳步增长；公司部分光电模组专用设备销售收入实现显著增长，形成新的利润增长点；公司收到的软件退税和政府补助同比增加，以及公司利用闲置资金用于理财投资，进一步促进了公司利润的增长。从而使2018年度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。报告期内，公司实现营业收入59,089.73万元，同比增长23.68%；实现营业利润10,573.53万元，同比增长13.66%；实现利润总额10,542.18万元，同比增长15.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,097.83万元，同比增长13.25%；实现基本每股收益0.38元，同比增长15.15%。

2015年至2018年公司年度营业收入和营业利润持续稳定上涨，具体变动走势如下图：



公司主要经营情况回顾如下：

（一）保持电子整机装联业务稳定增长

电子整机装联业务包含电子焊接类设备和智能机器视觉检测类设备，是公司销售收入的主要来源。报告期内，公司电子整机装联设备实现销售收入48,327.69万元，同比增长7.34%。其中电子焊接类设备实现销售收入41,927.87万元，同比增长6.76%，智能机器视觉检测设备实现销售收入6,399.82万元，同比增长11.27%。

1、优化产品性能，推动新品研发，保证电子焊接类设备销售稳定增长。

公司电子焊接类设备主要包括波峰焊、回流焊、垂直固化炉及其他焊接设备等。报告期内，公司及时把握行业动态，紧

跟市场方向，提升研发能力，持续优化老产品性能，同时积极与下游客户沟通交流，深入了解客户需求，及时研发新产品形成销售并投入使用，更精准的满足客户需求。公司推出智能高效回流焊和TEA系列回流焊，相比传统回流焊增加智能生产管理系统通讯联机功能；推出新型传动无尘立式炉，可实现炉内静态百级，动态千级无尘；推出Mini全程氮气双轨回流焊，可实现全程充氮；推出Mini一体式选择焊，可实现与AOI通讯，实现零缺陷补修功能；推出SE-II及SMART-II波峰焊，配置全新控制系统，提升产品品质。公司推行精益化生产，提升劳动生产率，缩短设备交货周期，快速响应客户需求；提升零件通用性，降低零件的流转，减少能源消耗，以适应新型市场经济的需求；对电子焊接类设备进行性能优化和智能升级，提升市场竞争力；公司自成立以来一直专注于电子整机装联设备领域内焊接设备的研发、生产和销售，积累了较为成熟的技术和经验，从而保障了公司电子焊接类业务经营持续向好，销售收入持续增长。

2、迎合市场需求，提升智能机器视觉检测设备销量。

公司智能机器视觉检测设备包括AOI和3D-SPI，主要应用于焊接工艺过程中的焊接良率检测并兼具修复功能。随着3C消费电子产品中高端化的发展趋势及知名品牌集中度的提升，下游电子产品模组的价值含量也随之提高，从而致使下游客户为提升良率，降低试错成本，需要对SMT产线焊接质量及焊前焊后的其他各生产环节的半成品或成品进行质量监测，因此下游客户对智能机器视觉检测设备的需求提升。报告期内，AOI方面，公司将大数据及人工智能引入到设备的应用中，多种机型（如JTA-JUTI-X、JTA-JUTI-MX和JTA-JUTI-1200）实现量产，并进一步完善JTA-660TB机型性能，增加了上下同时检测功能。3D-SPI方面，公司实现了SPI-Refine-X机型量产和SPI-Refine-1200机型的小批量生产。除AOI和3D-SPI之外，公司完成了异形插件机项目的前期调研和需求收集，并研发出样机在客户端批量验证。公司努力提升为客户提供智能机器视觉检测设备定制化服务的水平，并结合客户需求提升智能机器视觉检测设备的检测性能、检测效率及精准度，不断拓宽此类检测类设备的应用领域。

（二）光电模组生产专用设备取得突破性进展

2018年，公司新业务方面重点布局光电模组生产专用设备领域，加强与行业客户的互动交流，参与光电业务下游客户的招投标，积极宣传和推广公司光电模组生产专用设备。报告期内，公司光电模组生产设备实现销售收入9,096.91万元，占公司整体销售收入15.40%，相较2017年度增长689.62%，光电模组生产专用设备销售收入同比2017年度大幅提高。光电业务中贡献比较突出的是生物识别模组生产设备和摄像头模组生产设备，实现的销售收入分别为1,269.64万元和7,342.98万元。

1、生物识别模组生产设备助力公司打开光电业务市场。

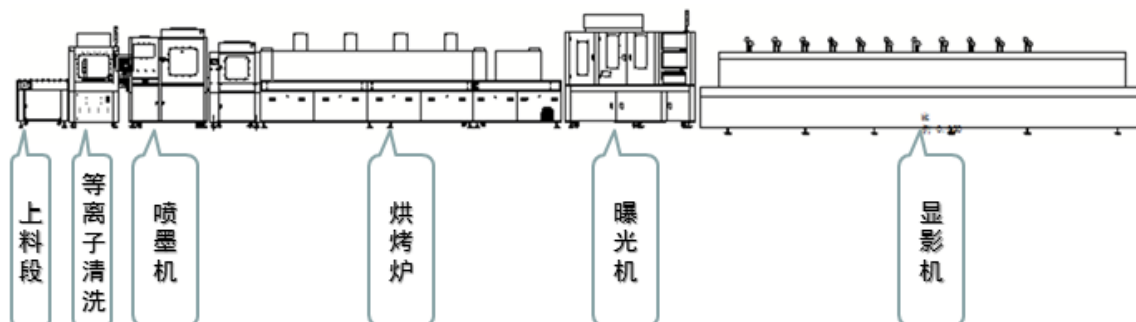
生物识别模组生产设备包括超声波指纹模组邦定设备、超声波指纹模组贴合设备和光学指纹模组封装贴合设备。随着全面屏手机的兴起和普及，有助于提高屏占比的屏下指纹识别技术得到快速发展，2018年屏下指纹识别技术应用规模逐渐扩大。从技术角度来看，目前主流的屏下指纹方案分别为光学方案和超声波方案，其中光学方案指在屏幕下方设置光学传感器，通过发出近红外光来识别用户的指纹纹路，超声波方案是在屏幕下方设置超声波传感器，通过超声波完成指纹识别工作。鉴于前期电容式指纹模组的技术储备与屏下指纹识别技术具有相关性，公司及时把握屏下指纹带来的市场机遇，适时研发出超声波指纹模组邦定设备、超声波指纹模组贴合设备、光学指纹模组贴合设备、光学指纹模组框胶贴附设备、光学指纹模组贴附设备、光学指纹模组封边点胶设备等，相关设备一经推出，便帮助公司成功进入光电模组生产专用设备市场，得到下游行业内知名厂商的认可和采购，打开了公司在光电业务方面的业绩增量空间。公司强大的研发制造实力和对新技术工艺高效的响应速度，为公司与行业客户之间建立更深层次的合作关系奠定了基础。

2、提升3D贴合设备良率，全力攻坚重点客户。

玻璃外壳是智能手机外观创新的主流方向，2018年市场上众多知名品牌的旗舰智能手机均配备了玻璃后盖。公司紧跟行业发展趋势，推出针对手机生产过程中显示模组后端工艺的自动真空贴合设备及3D曲面贴合设备，能够将3D盖板玻璃在真空状态下贴合、贴附、封边点胶机固化，实现玻璃盖板与色彩薄膜之间的贴合。公司持续优化现有3D曲面贴合设备的设计和速度，结合客户需求进一步提升设备良率，提高营销服务水平，全力攻坚重点客户。

3、3D玻璃设备实现整线销售。

报告期内，公司独立完成了3D盖板喷墨曝光显影整线自动化设备，已获行业客户试用，并获得高度认可。公司为国内首家研制该款3D玻璃盖板喷墨曝光自动化产线的厂家，设备整线配置如下：



报告期内，公司3D显影预烤、3D喷涂曝光线、无尘隧道炉、3D喷涂线、3D喷涂曝光线、曝光机以及3D车载喷涂曝光线均实现了销售收入。

4、持续完善显示屏模组封装设备，力争标准化与模块化。

公司显示屏模组封装设备包括全自动COG绑定机和全自动FOG绑定机，主要针对3C电子后端生产工序的显示屏模组封装设备，已实现销售，并获得业内主要客户认可。报告期内，公司持续完善COG邦定系列设备，形成标准化与模块化，并抓住COF工艺带来的市场机遇，扩大邦定产品线。

5、摄像头模组生产设备贡献收入，助力业绩增长。

进入2018年，3C电子领域双摄像头市场渗透率远超预期，摄像头模组产业技术不断升级，带来了三摄像头技术的应用和推广，市场需求旺盛。报告期内，公司依托国内大型模组厂商，积极迎合技术发展趋势，紧跟客户最新需求，挖掘新的业绩增长点，快速响应市场需求，成功研发出针对摄像头模组的生产设备，包括COB摄像头模组热压设备、摆料机、UV固化机及搭载机等，得到下游客户认可并实现销售，成为公司新的业绩增量点，助力公司业绩提升。

6、OLED设备完成样机生产。

公司OLED设备是指AMOLED外部补偿设备，主要是使用计算机软件算法完成对OLED面板色彩不均匀的修补。目前具体代表设备有Demura外部补偿设备，可用于实现OLED产品亮度和色度Mura的补偿，通过自动外部补偿设备完成OLED产品固定值设备Jig上、点灯、VCR、Mura补偿，提升产品良率，实现产品标准化，是公司进军OLED检测领域的重要尝试。报告期内，公司Demura外部补偿设备已完成样机生产，正在进行产品测试。随着智能手机市场的发展和5G时代的来临，手机全面屏和曲面屏时代开启，柔性AMOLED技术的发展和产能逐渐释放，为国内上游材料与设备企业带来新的发展机会，市场前景可期。

7、光电模组检测设备

(1) 触控显示一体模组点亮检测AOI可投入市场销售。

公司触控显示一体模组点亮检测AOI可用于手机及平板触屏及显示一体模组的点亮出现的显示不良的检测，可检测的项目包含：点、线缺陷；亮度及均匀性缺陷；MURA缺陷；显示异常等。报告期内，公司研制的该款设备已完成在客户端的测试，通过测试期间不断的优化更新设备软件，当前触控显示一体模组点亮检测AOI的撕膜检漏检率和检测水平均达到行业领先水平。

(2) 拓展AOI应用领域，研发销售CG AOI。

为应对客户端新工艺应用的需求，公司积极拓展光电检测类设备的应用领域，进一步提高光电产品竞争力，准备推出CG AOI，可以用于检测透明玻璃盖板表面划痕、崩边、裂纹、凹凸点，并检测油墨盖板表面划痕、油墨崩边、裂纹、凹凸点、牙缺、异色、漏光、漏边等。

8、突破OLED柔性屏相关3D贴合设备关键技术，研发新产品D-Lami贴合设备。

在平板显示器件中，相比传统LCD模组，OLED模组具备色彩饱和度更高、更轻薄、可视角度更大、可柔性弯曲、能耗

较低等优势，其应用不断得到推广，尤其是在智能手机端的渗透率逐渐提升，成为市场热点，未来市场空间广阔。以往OLED柔性屏相关3D贴合设备主要依赖国外进口，随着国外严控OLED相关技术的出口，国内的设备厂商在此领域凸显机会，公司积极与下游客户保持密切合作，联合攻坚相关技术难点，截至本报告披露日，公司突破了OLED柔性屏相关3D贴合设备开发瓶颈，完成了3D-Lami贴合设备样机生产，并在客户端进行验证。3D-Lami贴合设备可实现柔性oled屏与曲面玻璃盖板之间的贴合。公司已收到招标方绵阳京东方光电科技有限公司提供的关于该款设备的《中标通知书》，确认公司为绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目的中标方，详情可参阅公司于2019年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》。

除上述光电模组生产专用设备外，公司保持与下游客户的紧密合作，顺应市场发展趋势，开展前瞻性研发和布局，持续丰富公司光电模组生产专用设备类型，增加公司的产品覆盖范围，拓宽公司光电产品的应用领域，提升公司在光电市场的知名度和市场占有率，为公司持续发展贡献新的业绩增量。

（三）实施股权激励计划，增强公司凝聚力

为进一步建立、健全公司经营机制，保证公司持续稳定发展，建立和完善公司员工激励约束机制，充分调动员工积极性，增强公司凝聚力，为股东创造更多的业绩回报，公司于报告期内实施了430万股的限制性股票激励计划，其中首次授予345万股，预留85万股。报告期内，公司完成了向87名激励对象授予345万股限制性股票的授予登记手续。2019年1月22日，公司完成了向31名激励对象授予85万股限制性股票的授予登记手续。上述激励对象涵盖了公司部分非独立董事、高级管理人员及公司核心骨干人员。本次股权激励的实施有效提升了公司人才的稳定性，激发了公司管理团队和核心人才的动力和创造力，也有利于公司吸引和保留优秀的管理、技术、业务人员，进一步激发公司创新活力。

（四）实施精益生产，全力提升产能利用率

报告期内，随着公司光电模组专用业务的不断拓展，电子整机装联业务销售规模的不断扩大，公司原有生产场地不足问题凸显。为解决公司产能不足问题，公司通过实施精细化管理及精益生产，各车间、各工序每天对生产计划进行优化完善，实现生产资源充配置的最优化，降低存货周转周期，快速响应各方面的变化，最大力度缩短交货期；公司进一步细化生产工艺，推行标准化和模块化生产，提升产品质量，提高生产效率；公司充分利用现有生产场地及资源，进一步优化生产布局，用最少的地面积实现产量最大化，生产车间火力全开，产能实现满负荷运作，全力提升产能利用率；为了满足订单量的需求，公司承租了临近华佳工业园部分厂房和宿舍，用于组织生产和员工住宿，进一步扩充公司产能。

（五）加快公司自有新厂区的建设进度，推进募集资金投资项目结项

公司募集资金投资项目包括“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”及“研发中心建设项目”。2017年5月经公司第三届董事会第五次会议决议通过公司以自有资金对募集资金投资项目进行扩建并形成“劲拓高新技术中心”。报告期内，公司加快自有新厂区“劲拓高新技术中心”的建设进度，完成了新厂区主体工程的建设，各个分项验收也逐步落实。公司募集资金已使用完毕，公司及时对募集资金投资项目进行结项，并注销募集资金专户。新厂区建筑面积约7万平米，新厂区投产后，公司自有厂区建筑面积将由原来的约2万平米扩大至9万平米左右，能够极大的提高公司产能，为公司扩大生产经营规模和推进新产品的研发提供充足的场地支持，同时研发中心的建成也将有助于加强公司技术研发优势，确保公司在产品研发及技术创新方面处于行业领先地位。

（六）加强与投资者之间的良性互动，维护上市公司形象和价值

报告期内，公司通过接待投资者实地调研、投资者关系热线电话、电子信箱、传真、深交所互动易等多种渠道与投资者加强沟通交流，多渠道解答投资者的疑问，加深投资者对公司的了解和认同，同时通过举办业绩说明会，参加大型机构策略会等活动，增加机构研究人员及二级市场对公司的认知。通过与投资者之间的双向沟通，建立双方之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，树立公司公开、透明、诚信的企业形象，提高投资者对公司的认同度，从而促进公司长远发展，实现公司价值和股东利益最大化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子焊接设备类	419,278,720.77	71,295,113.99	39.13%	6.76%	0.15%	-3.32%
智能机器视觉检测设备	63,998,196.02	13,671,811.35	42.11%	11.27%	31.02%	0.49%
摄像头模组生产设备	73,429,765.38	1,756,997.17	25.21%	645.50%	20.14%	-11.78%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内第一次会计政策变更情况**1、变更原因**

为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则-基本准则》，2017年4月28日财政部对《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订，自2017年5月28日在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。并于2017年12月25日颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、本次变更会计政策对公司的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务报表无重大影响。

根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，将在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”项目，将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”；将原列示为“营业外收入”的与企业日常经营活动相关的政府补贴重分类至“其他收益”；同时根据文件要求对企业财务报表的格式进行调整。

上述会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润、现金流量等指标产生重大影响，只是会计科目列示的变化。本次会计政策变更符合财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定。

3、审议程序

《关于变更会计政策的议案》已经公司于2018年4月2日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告文件。

(二) 报告期内第二次会计政策变更情况

1、变更原因

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，公司将按照该通知规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

2、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

- (1) 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2) 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- (3) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- (4) “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (5) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- (6) 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- (7) “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- (8) 新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- (9) 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

4、审议程序

《关于会计政策变更的议案》已经公司于2018年10月22日，召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告文件。

(三) 报告期末至本报告披露日期间的会计政策变更情况

1、变更原因

2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

2、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、本次会计政策变更对公司的影响

金融工具相关会计政策变更如下：

(1) 金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

4、审议程序

《关于会计政策变更的议案》已经公司于2019年4月15日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告文件。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2019年4月17日